

附件：

武汉市促进集成电路产业发展的若干政策措施 (征求意见稿)

为深入贯彻国家、省集成电路产业发展战略部署，进一步推进我市集成电路产业高质量发展，加快发展新质生产力，结合工作实际，制定以下政策措施。

第一条 适用主体

依法登记注册，主营业务为集成电路设计、制造、封测、设备、零部件、材料、工业软件等环节的企业。依法登记注册的集成电路领域相关专业服务平台和投资机构。

第二条 支持设计环节创新发展

(一) 提升 IP 核、EDA 的设计支撑能力。对主营业务为集成电路 IP 核、EDA 工具且研发投入占营业收入比例达 15% 以上的企业，按照不超过企业年研发投入的 10% 给予最高 200 万元补助。(责任单位：市经信局)

(二) 支持集成电路产品首轮流片。对集成电路企业自主设计的新款产品首轮流片，按照不超过该款产品首轮流片费用(含掩膜版和 IP 购置费用)的 50%，先进制程(14nm 工艺以下)的产品给予最高 600 万元补助，成熟制程(14nm 工艺及以上)的产品给予最高 300 万元补助。(责任单位：市经信局)

第三条 支持重点领域强链补链

(三) 支持企业开展车规级芯片认证。对首次完成 AEC-Q100 标准认证的企业，按照认证费用 30% 给予一次性补贴，最高补贴

不超过 100 万元；对首次完成 ISO26262 功能安全标准（含功能安全流程认证和功能安全产品认证）的企业，按照认证费用 30% 给予一次性补贴，最高补贴不超过 150 万元。（责任单位：市经信局）

第四条 提升产业公共服务能力

（四）支持公共服务平台建设。对经认定的提供 EDA 工具和 IP 租赁、设计解决方案、先进工艺流片、先进封装测试等服务为主的集成电路公共服务平台，一次性给予平台实际建设投入 30% 的资助，最高资助总额不超过 1000 万元。（责任单位：市经信局）

（五）支持中试平台积极发挥效能。支持中小企业在经认定的中试平台开展设备、零部件、材料的测试和验证，推动新技术、新产品加快熟化。按照不超过测试验证费用的 30%，给予设备、零部件、材料企业提供最高 300 万元补助。每家企业年度补助总额最高 500 万元。（责任单位：市经信局、市科创局）

第五条 加强产业金融支持

（六）激发投资基金撬动作用。引导各类投资基金管理机构积极领投集成电路企业，鼓励 CVC（企业风险投资）母基金收购、并购国内外集成电路产业上下游企业。（责任单位：市经信局、市财政局、市委金融办、武汉投控集团、武汉金控集团）

第六条 鼓励人才引进培育

（七）培育孵化优质创业项目。聚焦高端光芯片、硅光半导体、量子芯片、先进封装、三维异构集成等未来产业前沿领域，孵化培育一批创业团队项目，对入选武汉市优秀集成电路创业团

队项目的，给予最高 500 万元种子资金或 500 万元银行贷款额度贷款市场报价利率（LPR）的全额贴息或 1000 万元股权投资的支持。（责任单位：市经信局、市人才工作局、市科创局、市委金融办、武汉投控集团、武汉金控集团）

第七条 附则

本政策措施自印发之日起实施，有效期至 2027 年 12 月 31 日。《市人民政府关于印发武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策的通知》（武政规〔2020〕18 号）同时废止。本市其他文件与本政策有重叠、交叉的，按照“从优、从高、不重复”的原则执行。政策执行过程中，如遇国家、省、市有关政策及规定有调整的，适用调整后的有关政策及规定。